

L/S = 15/15 $\mu$ mを実現  
**Hybrid Etching 装置**  
 (特許出願済)

特殊な添加剤を使用しないので低コスト

高いエッチファクターを量産で安定的に実現

新技術により表裏のエッチング形状が同等

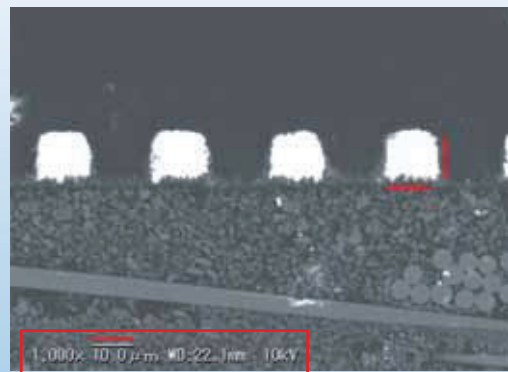
薄物搬送に適しており40 $\mu$ mの搬送が可能

基板へのインパクトが低くテンティングに有利

当社大宮開発センター開発装置でのL/S = 15/15 $\mu$ m

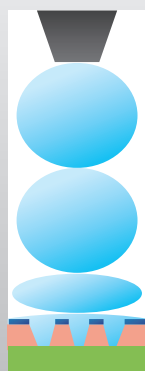


700x 14.2 $\mu$ m WD: 22.1mm 10kV

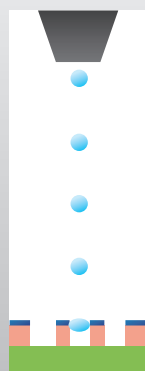


1,000x 10.0 $\mu$ m WD: 22.1mm 10kV

従来の  
スプレー



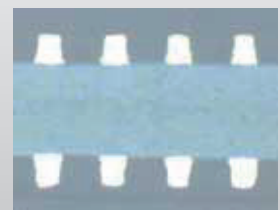
新開発  
スプレー



新開発ノズルで20 $\mu$ m粒径

狭ピッチパターンに対応

基板へのインパクトが低い



表裏同等の  
高いエッチファクター

お問い合わせ先